



推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
  - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
  - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76μm MIN金めっき
  - めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
: ニッケル下地の上に半田めっき
  - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
: ニッケル下地の上にスズめっき

△7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△7 OBSOLETE		Y	△6 △4	2-316133-5
		X	△6 △3	2-316133-3
			△6 △2	2-316133-2
			△6 △4	1-316133-5
			△6 △3	1-316133-3
			△6 △2	1-316133-2

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
B1	REV PER ECO-10-000445	KK AEG	11 JAN 10	WIRE RANGE	INSULATION DIA
B	REVISED (FJD0-0039-03)	TS SM	6/2 '03	mm(AWG -)	mmφ
A	REVISED (FJD0-0114-03)	TS SM	25 APR '03	MATERIAL	FINISH
0	RELEASED (FJ00-2557-95)	KI YI	2/AUG '95	DR. K.IKEDA	DE. K.IKEDA
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	APP. S.MANABE

NUMBER 316133  
 METRIC  
 3rd ANGLE PROJECTION  
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT  
 PRINT DIST  
 AMP-J REV.10/83